

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2026-075

宁波江丰电子材料股份有限公司

2026 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形

以区间数进行业绩预告的情况如下：

单位：万元

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：48,000		~	56,000	盈利：25,264.85
	比上年同期增长	89.99%	~	121.65%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：18,000		~	23,000	盈利：17,583.09
	比上年同期增长	2.37%	~	30.81%	

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，全球半导体产业拓展与人工智能技术迭代，AI 算力、存储芯片、逻辑芯片的需求持续释放，下游晶圆制造产能持续扩容。公司凭借领先的技术优势、先进的制造能力、稳定的产品质量、强大的核心装备以及全球化的技术支持、销售与服务体系，持续提升先进制程产品市场份额，超高纯金属溅射靶材的收入持续稳步增长。同时，得益于半导体精密零部件产线的多年布局，公司已成为国内多家知名半导体设备公司和国际一流芯片制造企业的核心

零部件供应商，气体分配盘、真空阀、加热器等核心产品持续放量，公司第二增长曲线半导体精密零部件产品收入持续增长。公司预计 2026 年半年度实现营业收入约 27 亿元，较上年同期增长约 30%。

报告期内，公司坚持技术创新，发挥自主创新优势，密切跟踪客户需求，不断加大先进制程产品的研发投入，努力扩大全球市场份额，国内外客户订单持续增加。公司积极推进超高纯金属溅射靶材募投项目的建设投产，目前黄湖靶材智能工厂所涉厂房已按计划建成，部分车间完成交付，车间智能化立体仓储、柔性自动化单元线、数字化生命周期系统集成等核心模块已完成单体测试，同时韩国江丰靶材工厂主体工程已投入建设，为公司加速全球化战略布局、提升国际竞争力奠定了坚实的基础。

公司持续加码半导体精密零部件的产能建设，以保障客户交付履约能力为目标，贴合客户需求，持续加大研发投入。公司紧握芯片制造商、半导体装备制造制造商对于扩大产能、实现自主可控的迫切需求，充分发挥资源整合、技术创新、市场开拓等综合优势，全面布局半导体精密零部件领域，目前公司正在加快推进静电吸盘、脆性材料等项目的建设和扩产，提高公司核心竞争力，为半导体零部件产业的自主可控提供重要支撑。

报告期内，公司紧抓全球半导体产业拓展与人工智能技术迭代的机遇，践行长期发展战略，在强化自主研发的同时，密切关注产业整合机会，聚焦半导体核心材料领域拓展，紧跟客户需求，积极扩展产业布局，为公司的长远发展打开空间。

2、报告期内，预计公司非经常性损益金额约 3 亿元-3.3 亿元，主要系公司战略投资的芯联集成公允价值变动、转让联营企业部分股权、平板显示靶材业务整合、权益法核算的投资收益按份额享有的被投资单位的非经常性损益、权益法核算的长期股权投资按照公允价值重新计量和政府补助等因素的综合影响。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

2、公司将在 2026 年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日